

Hall 2, Stand F33
2019.06.26

时间/ Time	演讲企业/ Company	演讲嘉宾/ Speaker	主题/ Topic
10:30-10:50	Infineon Technologies China Co., Ltd. 英飞凌科技（中国）有限公司	张明丹	CAV应用需求和面向CAV应用的IGBT的关键技术 CAV application requirement and Key technologies of IGBT for CAV application
10:50-11:10	Danfoss Silicon Power GmbH 丹佛斯硅动力有限公司	孟祥飞 高级应用工程师	铜绑定技术应用于汽车级碳化硅MOSFET模块的可靠性研究 Reliability of SiC MOSFET with Danfoss Bond Buffer in Automotive Traction Power Modules.
11:10-11:30	AkzoNobel (China) Investment Co., Ltd. 阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司	陈鹏飞 技术经理	环氧粉末涂料母排保护应用
11:30-11:50	Isabellenhuetten Heusler 伊莎贝棱辉特（上海）电子科技贸易有限公司	Darcy Qian FAE	Current sensing for POWER MODULES
11:50-12:10	Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd. 上海鹰峰电子科技股份有限公司	王宏凯 技术经理	车载直流支撑电容器选型设计方案
午休时间 / Lunch Break			
13:30-13:50	Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 三菱电机机电（上海）有限公司	王宝琦 高级应用工程师 Wang Baoqi Senior Field Application Engineer	电动汽车主驱用功率模块解决方案 Power Module Solutions for EV Drive
13:50-14:10	Power Integrations	Winson Wei	汽车级门极驱动器 SCALE-iDriver
14:10-14:30	惠州比亚迪电池有限公司 Huizhou BYD Battery Co.,Ltd	杨玮 CPF工厂副厂长	比亚迪电机控制器关键零部件-薄膜电容器技术应用与设计品质及未来规划--薄膜电容器技术应用与设计品质及未来规划
14:30-14:50			